



2024年度(2025年3月期) 決算概要について

新光電気工業株式会社

Brightening the Future
Since 1946



目次

2024年度 通期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 および今後の予定について	11
--	----

2024年度 通期決算概要（連結）

決算概況

（単位：億円）

	2023年度 通期	2024年度 通期	前年度比	
				増減率
売 上 高	2,100	2,150	+51	2%
営 業 利 益 (営業利益率)	248 (12%)	254 (12%)	+5	2%
経 常 利 益 (経常利益率)	273 (13%)	251 (12%)	△21	△8%
純 利 益※ (純利益率※)	186 (9%)	179 (8%)	△7	△4%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益	137.73円	132.30円
------------	---------	---------

2024年度 通期決算概要（連結）

概 況

- 半導体業界は、AI向けの需要拡大が継続するとともに、AI向けの設備投資を中心に半導体製造装置市場は堅調に推移した一方で、汎用サーバー、自動車、産業機器向け等は低調のまま推移し、在庫調整長期化の影響を受けるなど、需要動向の二極化がより鮮明となり、半導体業界全体の本格的な回復には至らない厳しい市場環境が継続。
- 当社グループにおいては、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、AI向け半導体等の設備投資拡大を背景とした需要増加などにより売上が増加し、I C組立はハイエンドスマートフォン向け等の需要拡大などにより、売上が増加。一方、フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れやパソコン向けの競争激化の影響などにより減収。
- 前期比で売上高2%増。利益面については、フリップチップタイプパッケージなどの減収等により、経常利益および純利益が減少。

2024年度 通期決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2023年度		2024年度		前年度比(%)
売上高 ※1			構成比(%)		構成比(%)	
	プラスチックパッケージ	1,278	(61)	1,227	(57)	△4
	メタルパッケージ	739	(35)	841	(39)	14
	そ の 他	83	(4)	83	(4)	△1
	合 計	2,100	(100)	2,150	(100)	2
経常利益 ※2			経常利益率(%)		経常利益率(%)	
	プラスチックパッケージ	118	(9)	54	(4)	△55
	メタルパッケージ	161	(22)	202	(24)	26
	その他/調整額	△7		△5		
	合 計	273	(13)	251	(12)	△8

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2024年度 通期決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

（単位：億円）

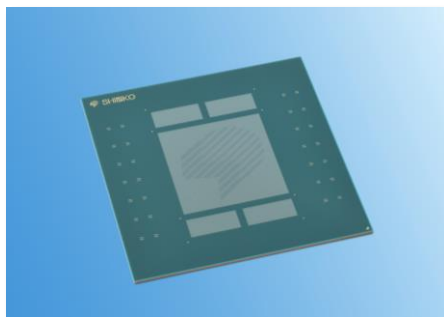
	2023年度	2024年度
総 資 産	3,938	3,971
純 資 産	2,650	2,834
自 己 資 本 比 率	67%	71%

	2023年度	2024年度
設 備 投 資 額 ※	637	194
減 価 償 却 費 ※	274	264
研 究 開 発 費	35	41
為 替 レ ー ト (1米ドル)	143円	150円

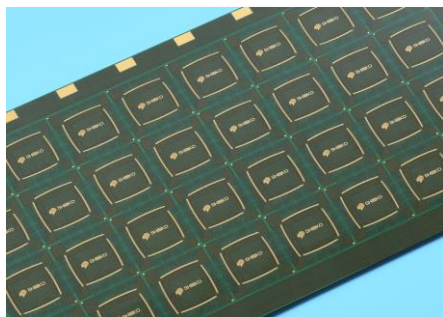
※ 無形固定資産を除く

2024年度 通期決算概要（連結）

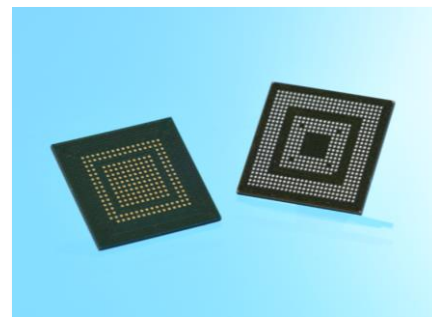
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

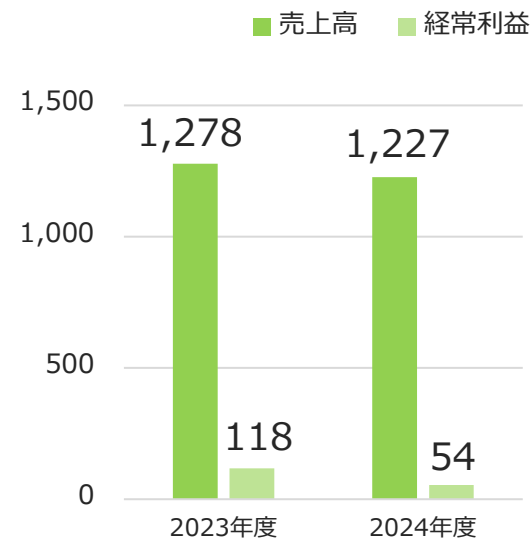
2024年度 通期決算概要（連結）

プラスチックパッケージ

（単位：億円）

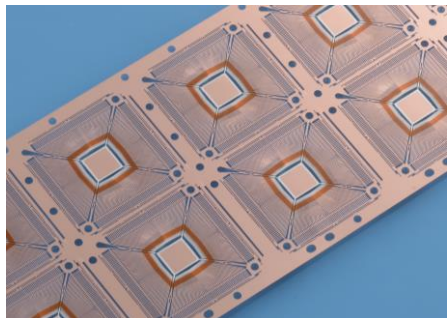
	2023年度	2024年度	前年度比	
				増減率
売上高（構成比）	1,278 (61%)	1,227 (57%)	△51	△4%
経常利益（経常利益率）	118 (9%)	54 (4%)	△65	△55%

- フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れやパソコン向けの競争激化の影響などにより減収
- プラスチックBGA基板は、先端メモリー向け等の在庫調整などの影響を受け減収
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向け等の需要拡大などにより売上が増加

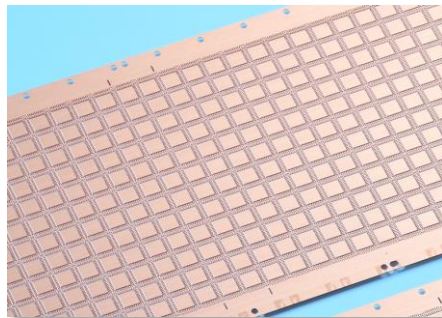


2024年度 通期決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

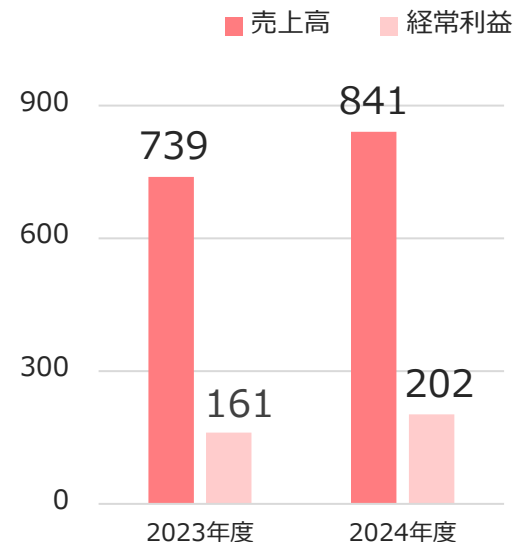
2024年度 通期決算概要（連結）

メタルパッケージ

（単位：億円）

	2023年度	2024年度	前年度比	
				増減率
売上高（構成比）	739（35%）	841（39%）	+102	14%
経常利益（経常利益率）	161（22%）	202（24%）	+41	26%

- 半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、AI向け半導体等の設備投資拡大を背景とした需要増加などにより売上が増加
- CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けの受注増加により増収
- ガラス端子は、光学機器向けの売上が前年並み
- リードフレームは、自動車向け等の在庫調整の影響を受けたものの、為替相場における円安の進行などにより売上は前年並み



2024年度 通期決算概要（連結）

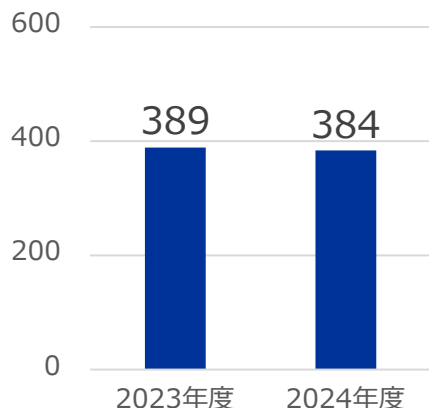
部門別売上高

（単位：億円）

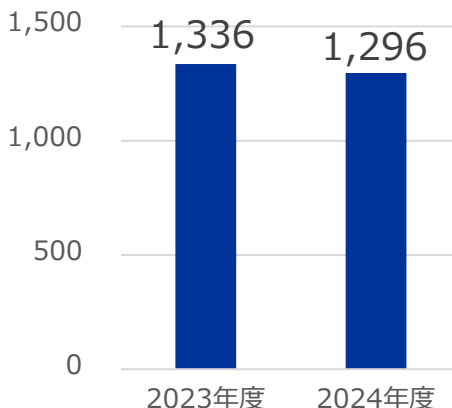
	2023年度	2024年度	前年度比	
			増減率	
I C リードフレーム	389 (18%)	384 (18%)	△5	△1%
I C パッケージ	1,336 (64%)	1,296 (60%)	△39	△3%
気 密 部 品	375 (18%)	470 (22%)	+95	25%

※（ ）は構成比

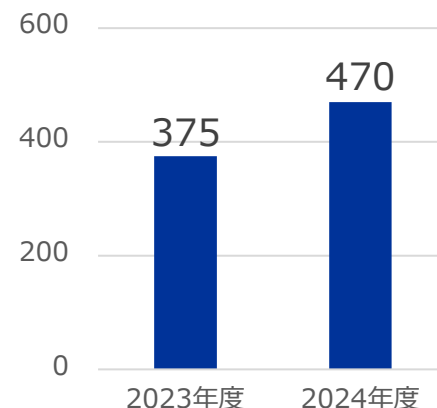
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 および今後の予定について

1. 公開買付けの結果について

2025年3月19日付「JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」において公表しましたとおり、JICC-04株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けは、2025年2月18日から開始され、2025年3月18日をもって終了し、応募された株式の数の合計が買付予定数の下限（22,491,200株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

2. 今後の予定

JICC-04株式会社は、当社を完全子会社化するための一連の手続を実施することを予定しており、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は所定の手続を経て上場廃止となります。

● 手続の日程（予定）

臨時株主総会開催 （株式併合・定款一部変更を付議）	2025年5月20日（火）
整理銘柄指定日	2025年5月20日（火）
最終売買日	2025年6月5日（木）
上場廃止日	2025年6月6日（金）
株式併合の効力発生日	2025年6月10日（火）

***なお、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定であることから、2026年3月期の業績予想は公表しておりません。**

※公開買付けおよび株式併合等に関する詳細は当社ウェブサイト掲載の「公開買付け・株式併合等について」をご覧ください。
https://www.shinko.co.jp/ir/stock_info/shareholder/tob.php

本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信を参照していただきますようお願いいたします。